

電路板製作資料清單

製作規格:

- 1.板號: RTL8762CMF_1V6_ExG-260716
- 2.層數: 4 Layer
- 3.電路板尺寸: 25 MM X 15 MM (單片尺寸----- 0片併板)
- 4.銅箔厚度: 0.5 盎司 / 平方呎 (外層:0.3~0.5 oz 內層: 0.5 oz) 依疊構計算為主
- 5.電路板厚度: 1MM ± 0.1 MM 疊構參考下圖
- 6.板材: ☒ FR-4 ☐ BT ☐ PI ☐ FR-4補強
- 7.表面處理: ☒ 噴錫, ☐ 鍍金, ☐ OSP(Entek) ☐ 鍍銀
- 8.數量: 80 PCS
- 9.預訂完成日期: 115 年 月 日.
- 10.表面防焊 ☐ 琥珀 ☐ 透明 ☒ 綠 ☐ 黑

交付資料:

- ☒ Gerber File, 檔名 : RTL8762CMF_1V6_ExG-260929(Gerber).zip
- ☒ Master Drawing主圖, 參考 內之檔案

製作完成後,請歸還所有資料

備註:

1. O/S TEST : YES , ☐單面 ☒雙面
- 2.金手指: NO
- 3.鍍金厚度: YES
- 4.阻抗控制: YES, 5mil 50ohm
- 5.AOI 測試: YES
6. BGA Substrate 特殊製程: NO
7. V-VUT: NO
8. 併板: NO
9. 排連片加版邊: YES
10. 盲埋孔: NO , ☒1階 ☐2階
11. 版邊電鍍 YES

收件廠商: 簽收人: 日期:

(請收件廠商簽收後傳回連絡人處!)

1. 本表單以板號作為資料之識別。
2. 本所所提供之技術資料,屬於本所之智慧財產權,僅限貴公司承製本案使用,用畢後應歸還本所,貴公司非經本所之書面許可,不得任意複製、使用、轉移、作為其他用途或移轉給第三者。